

# 工艺组周会会议纪要

2022.04.12 周二 16:00-18:00

## 会议内容

### • 郭宇

1. 磁吸活动平台测试：
  - 自动磁吸已功能实现，测试基本结束，准备评审
2. 新交付的镀膜高透剥离与现有玻璃无太大差别：
  - 持续跟进

### • 陈健

- 学习了解熟悉3D打印流程

### • 肖双喜

1. 材料测试机：
  - 基础工艺已验证OK，料盘加热已验证
    1. 23min——60°C
    2. 27min——60°C
- 打印幅面温差 $\pm 2^{\circ}\text{C}$ ，由于软件bug，暂时搁置
2. 清洗测试：
  - 已验证4种材料，清洗效果不错，后续进行蒸汽机、洗碗机清洗测试
3. LCD：
  - 测试内容已确认，准备开始测试

### • 邓凌峰

1. 低成本传感器测试+屏幕耐压测试
  - 需硬件测试支持，确定测试用例
2. LCD整机测试用例框架搭建
3. 原型机电机选型——测极限剥离力

### • 李倩芸

1. 空气料盘：
  - 剥离力过大分析排查，继续推进
2. 平台贴膜补充测试：
  - A2D测试中
3. 料盘封装：
  - 由于工程人力时间安排冲突，IE方案延迟至20号

### • 张思伟

1. 了解熟悉公司相关打印技术
2. 和李倩芸一起做打印测试

### • 张春阳

1. 调试设备
2. 跟进57电机自动加液测试

### • 李开武

1. 工艺包2.0导入：
  - 导入云端平台时格式问题导致导入失败

## 2. 工艺包2.0打印测试:

- 基托横纹非工艺包导致, 而是SF支撑方式问题

## 3. 抽层高度产生横纹, 正在排查问题

### • 黄俊

#### ○ 截面识别优化测试:

- M值工艺包打印精度问题: 优化工艺包对应段的等待时间及运动参数, 再进行打印测试
- 底板层比非底板层前若干层表面质量优: 排查原因, 目前推测可能由于轮廓填充策略导致, 待打印测试

### • 戴婉菁

#### ○ VT光机测试:

- 最新上位机软件打印标牙, 分割代型满足要求, 但目前光强仍有0.2~0.3的下降, 后续根据光学测试结果, 进行长时间打印测试, 确定是光机光强正常波动还是光强衰减
- 上位机软件会先将4K图拆成2K图, 所用的策略如灰度过滤, 加Diff值都是在2K图上处理的。在打印分割代型时出现调Diff值模型的适用diff值与Diff验证模型适用diff值相差较大的问题, 后续需确认是在2K还是4K图上使用工艺策略